



HSPT-02 **双五点热封试验仪**（又称热封梯度仪），采用热压封口测试原理,适用于测定软包装复合膜、塑料薄膜基材、涂布纸及其它热封复合膜的热封压力、热封温度和热封时间等参数；是实验室、科研、在线生产中不可缺少的试验仪器。

一、基本信息

品名	双五点热封试验仪	型号	HSTP-02
品牌	泉科瑞达	产地	山东.济南

二、产品特征

五个上热封头与 1 个下封头采用独立 PID 温度控制单元，独立控温

40mm 宽封头设计可满足单封头实现双 15mm 宽试样的制备需求

六组 PID 温控单元内置，外观整洁；下位机系统与 PID 单元通信连接，触摸屏操作所有温控及设置

手动和脚踏两种试验模式，人机交互友好，防烫伤人性化安全设计



国际品牌气动元件、PID 温度控制器、进口高速高精度采样芯片，保证试验条件准确

7 寸高清彩色触控液晶屏，方便试验操控，界面适时显示设定温度与实际温度、压力、时间

菜单式界面，各项试验功能独立菜单式操作，参数设置与试验操作方便

温度：上下封头热封温度双 PID 控制，温度控制精度高

压力：数字压力传感器显示，压力调整与控制精度高；

时间：磁性（行程）开关计时，消除空行程时间，实现时间参数的精准控制

开机密码登陆，防止非相关人员随意开机，四级权限管理

标配微型打印机，具有数据查询、统计、打印功能

运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器安全

专业 GMP 计算机通信软件可选，以实现数据溯源、多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能

三、测试原理

熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料，会表现出不同的热封性能，其封口工艺参数可能差别很大。热封试验仪采用热压封口法，将待热封试样置于上下热封头之间，在预先设定的温度、压力和时间下，完成对试样的封口，通过在不同的温度、压力和时间等试验条件下对试样热封合试验，再配合相关检测仪器可获得精确的热封性能指标。

四、产品应用领域

基础应用	薄膜材料	适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验，热封面为光滑平面，热封宽度可以根据用户的需求进行设计
-------------	------	--

五、技术指标



指标	参数
热封头数量	5 个上封头, 1 个下封头 (共用)
热封温度	室温 ~ 250°C
热封压力	0.1 MPa ~ 0.7 MPa (取决于热封面积, 共用压力系统)
热封时间	0.1 ~ 9999.9s
控温精度	±0.2°C
温度梯度 (递增)	≤20°C
热封面积	40mm×10 mm(可定制)*5 点 40mm 试样幅宽可实现一个封头制备二个试样
加热形式	双加热 (可独立控制)
气源压力	0.7 MPa ~ 0.8 MPa (气源用户自备)
气源接口	Φ6 mm 聚氨酯管 (压缩气源用户自备)
电源	标配: AC 220V 50Hz
外形尺寸	580mm (L)×400 mm (W)×510 mm (H)
净重	约 40kg (不含包装箱)

六、参考标准

QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003

七、产品配置

标准配置: 主机、脚踏开关、微型打印机

选购件: 专业软件、通信电缆、加长聚氨酯管

备注: 本机气源接口系Φ6mm 聚氨酯管 (如需要Φ8mm 需约定); 气源和气源转接头用户自备; 若加购软件则计算机 (仪器可脱离计算机独立工作) 均由用户自备。



注：泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应更改。上述情况恕不另行通知，您可登陆 www.qktester.com 获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。